

概要

この通知は、ChipScope Pro および University ISE Design Suite についての開発システム製品が製造中止となることをお知らせするものです。ES シリコンを使用する Zynq 開発製品の代替製品は、プロダクション シリコンを使用する開発製品です。

説明

ザイリンクスは定期的に見直しを実施しており、その結果、次の製品の変更を決定いたしました。この通知と併せて、これまでに発行された製造中止製品の通知もご一読ください。過去の通知は次のサイト (http://japan.xilinx.com/support/documentation/customer_notices.htm) から入手できます。

該当製品

1. [ChipScope Pro](#)
2. [University ISE Design Suite](#)
3. [Zynq 開発キット](#)

表 1：製品番号 – ChipScope Pro

製品番号	説明	代替製品
EF-CSP-SIOTK-NL	ChipScope Pro Standalone Including Serial IO Toolkit, Node-Locked License	EF-VIVADO-DEBUG-NL
EF-CSP-SIOTK-FL	ChipScope Pro Standalone Including Serial IO Toolkit, Floating License	EF-VIVADO-DEBUG-FL
DO-CSP-PRO-USB-II-G-NL	ChipScope Pro with USB-II Cable, Node-Locked License	DO-VIVADO-DEBUG-USB-II-G-NL
DO-CSP-PRO-USB-II-G-FL	ChipScope Pro with USB-II Cable, Floating License	DO-VIVADO-DEBUG-USB-II-G-FL

表 2：University ISE Design Suite

製品番号	説明	代替製品
UEF-ISE-LOG-25	University ISE Design Suite : Logic Edition, 25 License Bundle	UEF-VIVADO-DESIGN-25
UEF-ISE-LOG-50	University ISE Design Suite : Logic Edition, 50 License Bundle	UEF-VIVADO-DESIGN-50
UEF-ISE-EMBD-25	University ISE Design Suite : Embedded Edition, 25 License Bundle	UEF-VIVADO-DESIGN-25
UEF-ISE-EMBD-50	University ISE Design Suite : Embedded Edition, 50 License Bundle	UEF-VIVADO-DESIGN-50
UEF-ISE-DSP-25	University ISE Design Suite : DSP Edition, 25 License Bundle	UEF-VIVADO-SYSTEM-25
UEF-ISE-DSP-50	University ISE Design Suite : DSP Edition, 50 License Bundle	UEF-VIVADO-SYSTEM-50
UEF-ISE-SYSTEM-25	University ISE Design Suite : System Edition, 25 License Bundle	UEF-VIVADO-SYSTEM-25
UEF-ISE-SYSTEM-50	University ISE Design Suite : System Edition, 50 License Bundle	UEF-VIVADO-SYSTEM-50

表 3 : 製品番号 – Zynq 開発キット

製品番号	説明	代替製品
EK-Z7-ZC702-CES-G	Zynq-7000 EPP ZC702 Evaluation Kit	EK-Z7-ZC702-G
EK-Z7-ZC702-CES-G-J	Zynq-7000 EPP ZC702 Evaluation Kit Japan Specific	EK-Z7-ZC702-G-J
EK-Z7-ZC706-CES-G	Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit	EK-Z7-ZC706-G
EK-Z7-ZC706-CES-G-J	Zynq-7000 SoC ZC706 Evaluation Kit Japan Specific	EK-Z7-ZC706-G-J
DK-Z7-VIDEO-CES-G	Zynq-7000 Video and Imaging Kit	DK-Z7-VIDEO-G
DK-Z7-VIDEO-CES-G-J	Zynq-7000 Video and Imaging Kit Japan Specific	DK-Z7-VIDEO-G-J

キーデータおよび注文情報

ChipScope Pro

新規見積または新規受注の受付はありません。

締結済みの保証契約は製品の製造中止後も履行されますが、更新はされません。

University ISE Design Suite

新規見積または新規受注の受付はありません。

締結済みの保証契約は製品の製造中止後も履行されますが、更新はされません。

Zynq 開発キット

この製品の在庫はなく、2013 年 8 月 1 日をもって製造中止となる予定です。

表に示す代替キットは、既に注文いただけます。

注記 :

1. オリジナル Spartan FPGA ファミリをサポートするソフトウェア バージョンは、ISE® 4.2 までです。これは次のサイト「ISE Classics」からダウンロード可能です。
http://japan.xilinx.com/webpack/classics/spartan_4k/index.htm
2. オリジナル Virtex FPGA ファミリをサポートするソフトウェア バージョンは、ISE® 10.1 までです。これは <http://japan.xilinx.com/support/download/index.htm> からダウンロードできます。

テクニカル サポート

これらの製品についてのサポートは、ソリューション センター ([ザイリンクス アンサー 40174](#)) を参照してください。今後、これらの製品に対するサポートは、ツールの使用方法および発行済み資料に関する内容に限られます。

お問い合わせ

製品在庫に限りがある場合がございますので、製品の LTB (Last-Time-Buy) 注文は、上記のキーデート以前に時間的余裕をもってご注文ください。また、LTB 注文が現時点のレート以上になることが予想される場合、ご注文の見通しをザイリンクス販売代理店までご連絡ください。すべての注文は、先着順の形で対応させていただきます。また、LTB の 60 日以内の注文につきましては NCNR (Non-Cancellable and Non-Returnable) となります。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、ザイリンクス販売代理店までお問い合わせください。

重要なお知らせ : カスタマー通知 (XCN, XDN, Quality Alert) リリースのお知らせは、ザイリンクスのサポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照してください。

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2013 年 7 月 29 日	1.0	初版
2013 年 8 月 12 日	1.1	「概要」の文章の更新

Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at <http://www.xilinx.com/legal.htm#tos>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at <http://www.xilinx.com/legal.htm#tos>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN13025、バージョン 1.1、2013 年 8 月 12 日発行) を翻訳したものです。